

# ● ミリ波対応低損失基板 CGD-500 シリーズ



## ● 製品概要

- 新規ふっ素樹脂材料を使用した、ガラス/ふっ素樹脂による複合基板です。
- 従来のガラス/ふっ素樹脂複合基板と比較して、低伝送損失が実現できます。
- 銅箔との密着性が良好で、表面粗度の小さいLOWプロファイル銅箔使用時の引き剥がし強度が高い製品です。
- ミリ波帯域での伝送損失は、世界最高レベルを有します。

## ● 特長

- ミリ波帯域での伝送損失が極めて小さい
- 優れた高周波特性
- ドライブプロセス等に適応可能

## ● 用途例

- 車載用レーダー
- 衝突防止用レーダー
- 高度道路交通システム 等

## 製品性能

試験項目	単位	測定値	試験条件
比重	-	2.2	A
引き剥がし強度	kN/m	1.20	A
吸水率	%	0.005	E-24/50 + D-24/23
はんだ耐熱性	-	異常なし	260°C・1分
体積抵抗率	Ω-cm	5×10 <sup>16</sup>	A
		1×10 <sup>16</sup>	C-96/40/90
表面抵抗率	Ω	6×10 <sup>16</sup>	A
		4×10 <sup>12</sup>	C-96/40/90
絶縁抵抗	Ω	1×10 <sup>15</sup>	A
		1×10 <sup>14</sup>	D-2/100
比誘電率	-	2.28	円板共振法 (Z軸) 12GHz
誘電正接	-	0.0015	円板共振法 (Z軸) 12GHz

試験項目	単位	CGD-500 (厚み: 0.25mm)	CGP-500 (厚み: 0.33mm)	試験条件
伝送損失	dB/mm	0.056	0.09~0.10	CPW伝送損失 76GHz

- \* 試験に使用した基板は、厚み t=0.25mm(銅箔厚み 12μ) を使用。
- \* CGP-500は、弊社のふっ素樹脂銅張積層板のスタンダード品です。
- \* 上表の数値は測定値であり、規格値ではありません。

## 一般寸法表

製品名	製品寸法及び公差 (mm)	製品厚み及び公差 (mm)
CGD-500	460w +5, -0 ×	0.135±0.015
	610L +5, -0	0.245±0.020

- \* 製品厚み及び公差の数値は銅箔を含みます。

### 中興化成工業株式会社

本 社 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7    ATT新館10階    03-6230-4414 (代)  
 東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7    ATT新館10階    03-6230-4411  
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3    錦パークビル10階    052-229-1511  
 大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30    ニッセイ新大阪ビル16階    06-6398-6714  
 福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12    大手門パインビル5階    092-724-1411

お問い合わせ: support@chukoh.co.jp

#### ⚠ 取扱上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対に行わないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート (SDS)、ふっ素樹脂取り扱い手引きをお読みください。